

Descrizione del prodotto

Finitura: questa scheda deve essere placcata in oro a immersione secondo IPC-6012. Spessore deve essere. 050uM oltre 3-6uM nichel.

Fori di rame piastra minima .025 AVG,. 020 min.. I fori non possono essere collegati

Imballi con la pellicola trasparente incolore della bolla, 25 pc/sacchetto, dissecante messo nel fianco, metta la scheda dell'indicatore di umidità sul lato superiore

Struttura del layer

L1-----Hoz

-PP 0.234 mm-

--

L2-----1

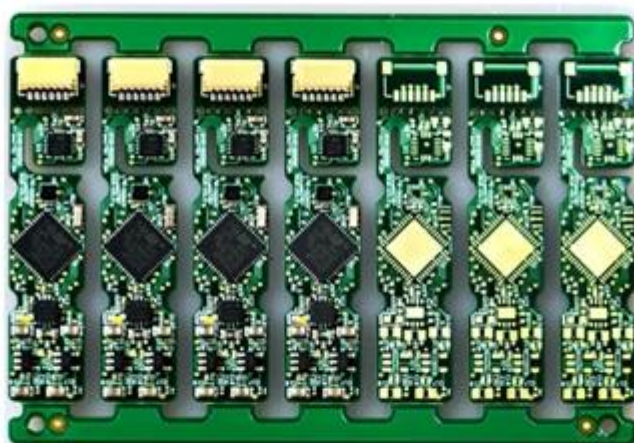
-COre 0.127 mm-

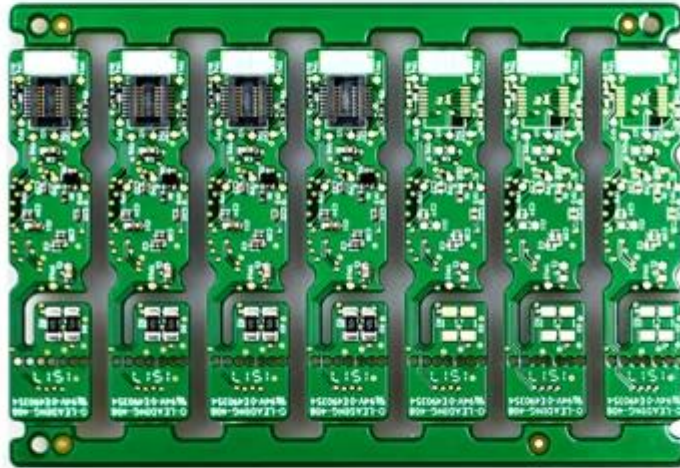
L3-----1

--

-PP 0.234 mm-

L4-----Hoz





www.o-leading.com



www.o-leading.com



www.o-leading.com

[LED PCB Board circuito stampato](#)